

2012年3月期 決算説明会資料

2012.5.24



三信電気株式会社
代表取締役社長 松永 光正
(証券コード:8150)

※ 資料取扱い上のご注意

このプレゼンテーションで述べられている業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測であって、潜在的なリスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、様々な要因により予想数値と大きく異なる可能性があります。実際の業績に影響を与える重要な要因として主なものは以下の通りです。

- 日本・北米・アジア等の経済情勢、消費動向
- 販売先の生産動向や製品開発
- 仕入先の供給状況や製品開発
- 競争激化による価格下落
- 為替相場の大幅な変動等

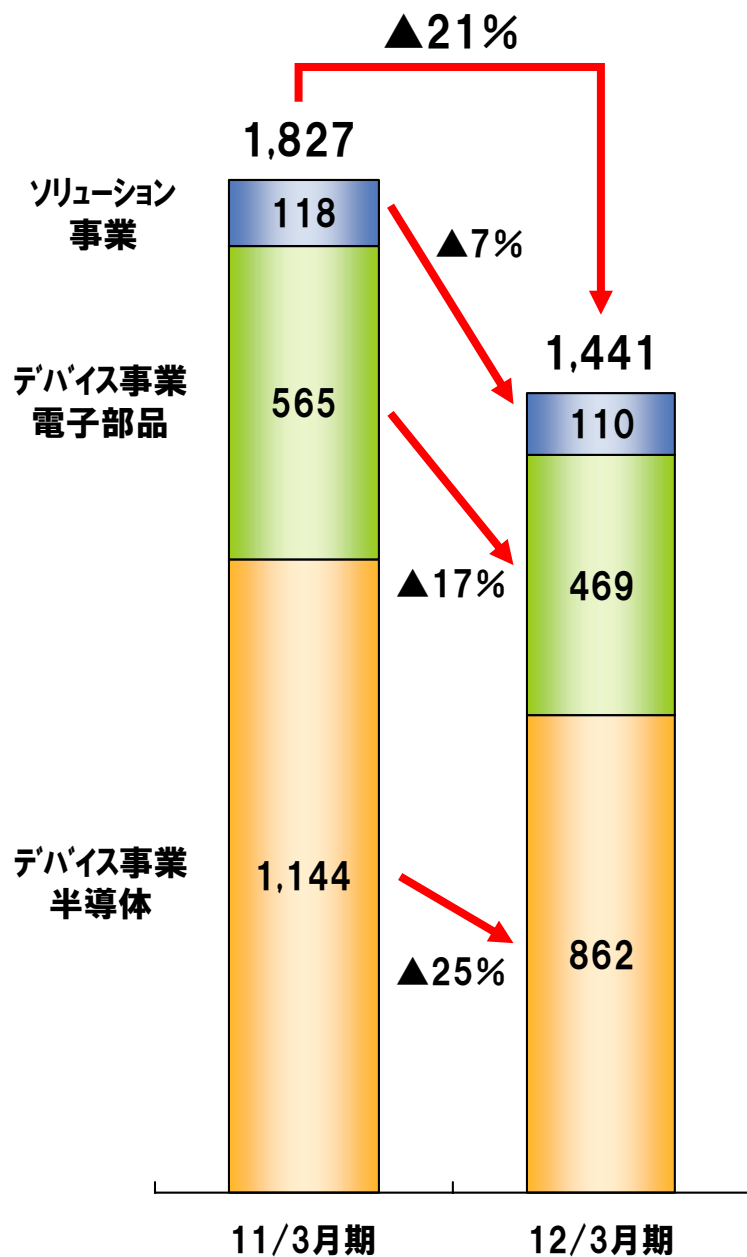
. 2012年3月期

業績概要

- 売上高は前期比▲21% (TOY分野▲40%、TOY分野以外▲16%)
- 営業利益/経常利益/当期純利益は、売上高減少により大幅減益

	11/3期 実績	12/3期 実績	前期比	※ 予想	達成率
売上高	1,826.7	1,441.6	79%	1,470.0	98%
売上総利益	6.3% 115.7	7.2% 104.4	90%	7.0% 102.5	102%
販管費	5.1% 94.0	6.5% 94.3	100%	6.4% 94.5	100%
営業利益	1.2% 21.6	0.7% 10.1	47%	0.5% 8.0	126%
経常利益	1.2% 22.6	0.6% 8.0	36%	0.5% 8.0	100%
当期純利益	0.8% 14.5	0.4% 5.2	36%	0.3% 5.0	103%
連結ROE	2.4%	0.9%	増減 △1.5P	0.9%	増減 ±0P
換算レート (1米ドル)	¥85.72	¥79.07	増減 △¥6.65	¥78.00	増減 +¥1.07

※予想は、平成24年2月3日(第3四半期決算)に修正した予想数値



■ デバイス事業は▲22%、ソリューション事業は▲7%
 ■ 品目別では、機構部品/回路基板が堅調に推移

	11/3月期 実績	12/3月期 実績	前期比
連結合計	1,827	1,441	▲21%
デバイス事業計	1,709	1,331	▲22%
半導体	1,144	862	▲25%
SoC	646	395	▲39%
マイコン	176	170	▲3%
A&P ※	212	211	▲0.4%
他半導体	110	86	▲23%
電子部品	565	469	▲17%
機構部品	243	258	+6%
回路基板	45	48	+6%
他電子部品	276	163	▲41%
ソリューション事業計	118	110	▲7%

※A&P・・・アナログ&パワー半導体

- デバイス事業は、売上高減少が響きセグメント利益で前期比▲79%の減少
→デジタル家電/TOY分野の低迷、東日本大震災/タイ洪水被害の影響、仕入先統合による人員増強
- ソリューション事業は、売上高減少もセグメント利益は前期比で大幅増加
→保守/サポートなどのノンハード分野の売上総利益率が向上、販管費の削減

		11/03期 実績	12/3期 実績	前期比	※ 予想	達成率
デバイス 事業	売上高	1,708.6	1,331.3	78%	1,360.0	98%
	セグメント利益	1.1% 18.9	0.3% 4.0	21%	0.3% 4.0	100%
ソリューション 事業	売上高	118.1	110.3	93%	110.0	100%
	セグメント利益	6.1% 7.2	8.4% 9.3	129%	7.3% 8.0	116%
換算レート(1米ドル)		¥85.72	¥79.07	増減 △¥6.65	¥78.00	増減 △¥1.25

※①デバイス事業及びソリューション事業のセグメント利益の合計は、各事業に配分していない管理部門に関わる費用などの調整額の記載を省略している為、連結損益計算書の経常利益と一致していません

※②予想は、平成24年2月3日(第3四半期決算)に修正した予想数値

. 2013年3月期 通期業績予想

◆ 世界経済

- 日本経済はプラス成長を期待
→ 復興需要の本格化
→ 企業業績回復
- 米国、アジアも回復を見込む
- 欧州、原油高など下振懸念も

◆ エレクトロニクス市場

- 世界電子情報産業生産見通し
→ 前年比5%増、堅調な推移
- 日系企業は前年比2%増
→ 国内生産は横這い、又は微増

※出典 JEITA

◆ 半導体業界

- 穏やかながらも成長に期待
→ 前年比2%台の成長を予想
→ 足元は前年比割れが続く

※出典 SIA

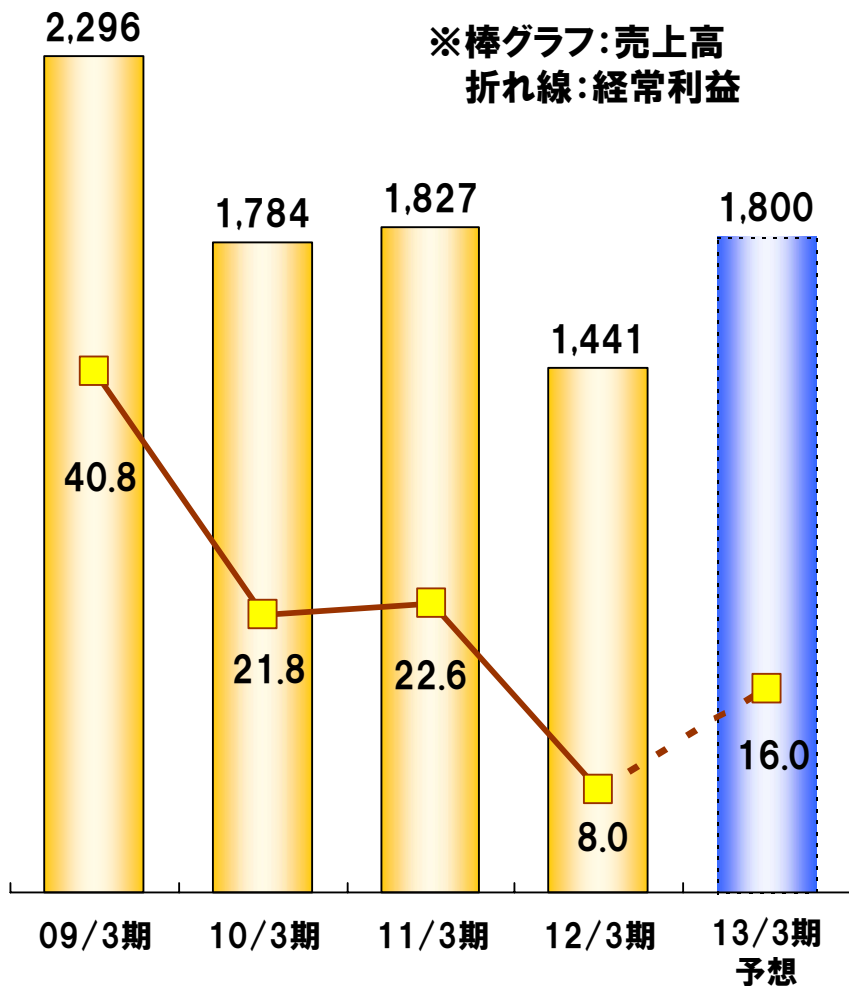
◆ 日本IT投資

- 11年は当初予想よりマイナス縮小
- 12年はプラス成長と予想
→ 大企業2.5%増
→ 中堅中小企業1.5%増

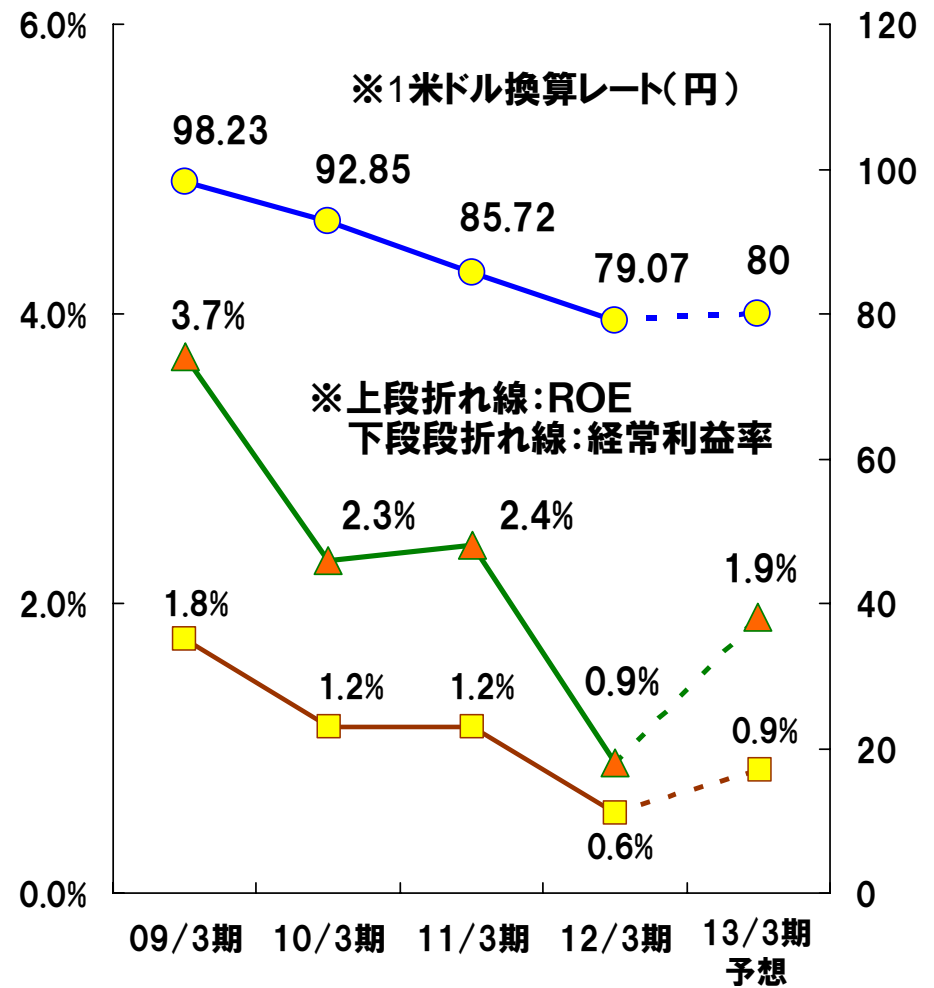
※出典 IDCジャパン

■ 13年3月期予想は増収増益も11年3月期を下回る、早期に業績の回復に努める！

売上高・経常利益



ROE・経常利益率



- 通期売上高は前期比+25%（前年同期比:上期 +1%、下期 +53%）
- 通期営業/経常/当期純利益は、売上高の増加により大幅な回復を見込む
- 新規セットの立ち上がりが第2四半期以降の為、業績の回復は下半期の見通し

	11/3期 実績	12/3期 実績	13/3期		前期比	
			上期	下期		
売上高	1,826.7	1,441.6	800.0	1,000.0	125%	
売上総利益	6.3% 115.7	7.2% 104.4	6.4% 51.5	5.9% 59.2	6.2% 110.7	106%
販管費	5.1% 94.0	6.5% 94.3	5.9% 47.5	4.9% 48.7	5.3% 96.2	102%
営業利益	1.2% 21.6	0.7% 10.1	0.5% 4.0	1.1% 10.5	0.8% 14.5	144%
経常利益	1.2% 22.6	0.6% 8.0	0.6% 5.0	1.1% 11.0	0.9% 16.0	200%
当期純利益	0.8% 14.5	0.4% 5.2	0.4% 3.5	0.8% 7.5	0.6% 11.0	213%
連結ROE	2.4%	0.9%	—	—	1.9%	増減 +1.0P
換算レート (1米ドル)	¥85.72	¥79.07	¥80.00	¥80.00	¥80.00	増減 +¥0.93

- デバイス事業は増収増益も11/3期を下回る、第2四半期以降の回復を見込む
- ソリューション事業は売上高増加もセグメント利益横這い、収益率7%台は維持

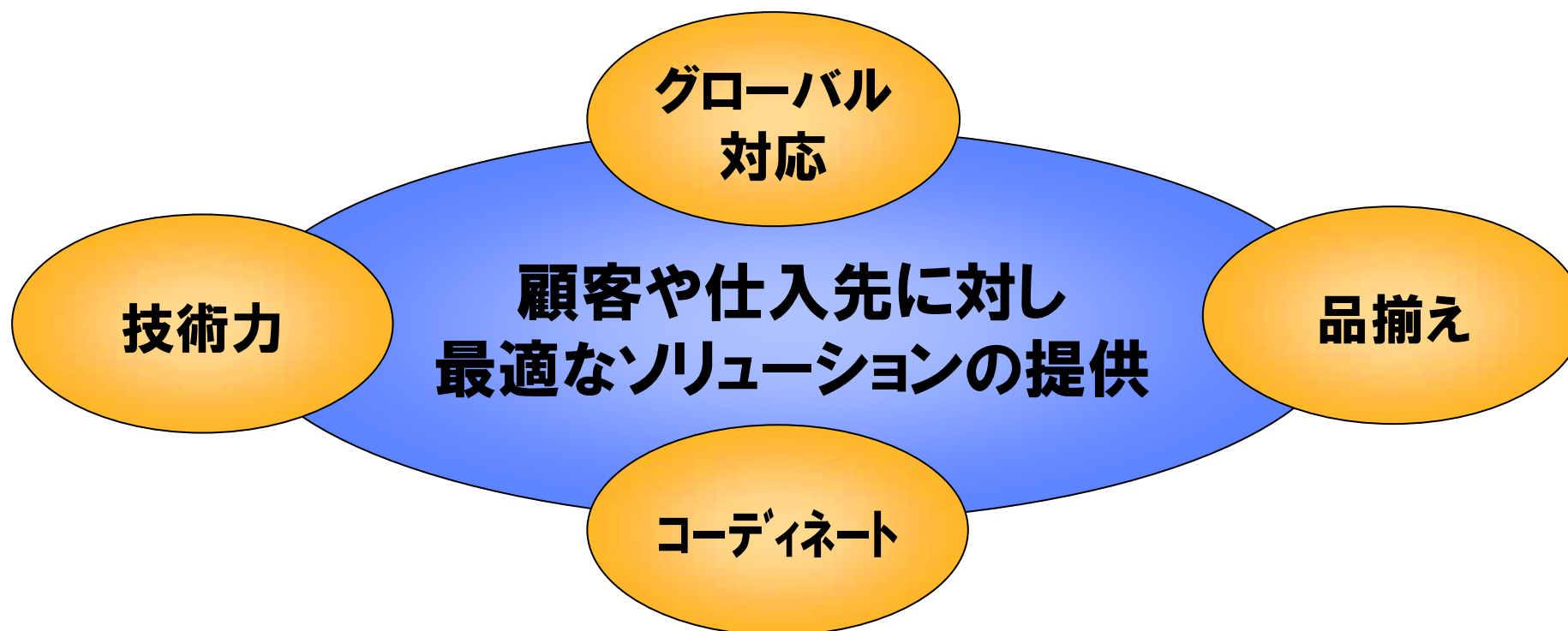
		11/3期 実績	12/3期 実績	13/3期		13/3期 通期予想	前期比
				上期	下期		
デバイス 事業	売上高	1,708.6	1,331.3	740.0	930.0	1,670.0	125%
	セグメント利益	1.1%	0.3%	0.5%	0.7%	0.6%	
		18.9	4.0	3.5	6.5	10.0	251%
ソリューション 事業	売上高	118.1	110.3	60.0	70.0	130.0	118%
	セグメント利益	6.1%	8.4%	5.8%	8.3%	7.1%	
		7.2	9.3	3.5	5.8	9.3	100%
換算レート(1米ドル)		¥85.72	¥79.07	¥80.00	¥80.00	¥80.00	増減 +¥0.93

※デバイス事業及びソリューション事業のセグメント利益の合計は、各事業に配分していない管理部門に関わる費用などの調整額の記載を省略している為、連結損益計算書の経常利益と一致しておりません

・ 経営方針 / 重点課題

「信頼とソリューションで 存在価値を発揮する三信電気」

- ★顧客へは最適商品の安定供給 ⇒ 当社存在価値の向上
- ★仕入先へは販売機能の強化



新たな視点 & 取り組みを導入し強い収益体質を構築する

1. 事業力の強化

- ① **拡販製品、分野の再構築（デバイス事業）**
- ② **海外ビジネスの展開力の強化（デバイス事業）**
- ③ **ストックビジネスの拡大（ソリューション事業）**

2. 経営基盤の整備

- ① **人材の強化とインフラ整備**

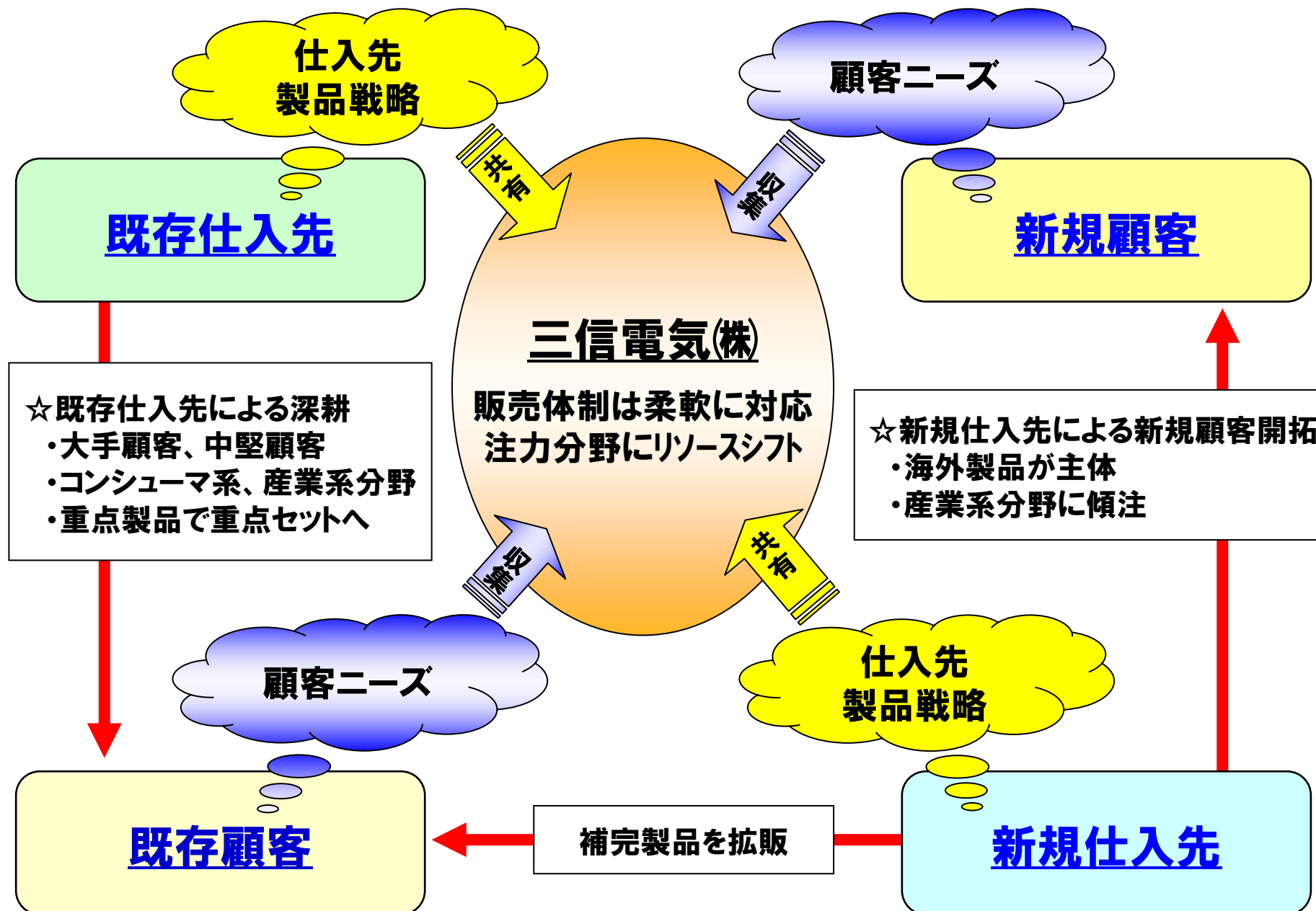
1. 拡販製品、分野の再構築

☆効果的な拡販活動 & 拡販分野の拡大



- ・顧客の事業ポートフォリオの再編
- ・EMS／ODM比率の拡大
- ・仕入先の戦略製品の見直し

- ①顧客戦略の見極め、仕入先戦略との整合による販売体制見直し
 - ・13/3月期セグメント利益予想は10億円（前期比151%増）
 - ・注力セグメント(製品、分野)へ人員シフトを行い、効果的な拡販活動を推進
- ②顧客ニーズに伴う新たな仕入先による製品ラインアップの拡充
 - ・既存仕入先の製品戦略を見強め、これを補完できる新規仕入先を発掘
- ③注力すべき拡販分野の明確化と新規商流獲得による顧客開拓
 - ・コンシューマ系分野への継続した拡販と産業系分野への取り組み強化
 - ・海外製品を中心とした新規仕入先による新規顧客の開拓



2. 海外ビジネスの展開力の強化

☆拡大する海外 の対応強化



- ・海外への生産移管は更に加速
- ・移管先の地理的な広がり

①EMS／ODM企業への継続した拡販の推進

- ・13/年3月期海外現法売上高予想は708億円(前期比▲2%)
- ・上記の内、主要EMS/ODM売上高前期比32%増
- ・確実な刈り取り、移管ビジネス以外でのデザインイン強化、営業の広域化への対応

②現地設計の拡大に対応するエンジニアスキル向上

- ・国内からの技術サポート強化、現地エンジニアの増強(駐在員&ローカル社員)

③人的リソースの適正配置やロジスティクスの整備等による対応強化

※EMS・・・電子機器の受託製造サービス、ODM・・・相手先ブランドによる設計製造

3. ストックビジネスの拡大

☆ 既存顧客の深耕 & 新規顧客の開拓



- ・ビジネス領域が幅広く存在
- ・ビジネス領域ごとに顧客が異なる

- ① **ビジネス領域の融合を図り、既存顧客の深耕を推進**
 - ・13/3月期セグメント利益予想は9.3億円、ストック総利益構成比率は35%
 - ・NW、セキュリティ、ビジネスアプリケーション、映像コンテンツ編集システム等の融合を図る
- ② **ビジネスパートナーとの協業を推進し、新規顧客の開拓に注力**
 - ・顧客業務の取り込み、ワンストップサービス、全国展開、24H365日対応etc
- ③ **計画的な資格取得、技術スキルの共有や水平展開**

1. 人材の強化とインフラ整備

☆事業環境変化への 対応力の向上



- ・目まぐるしく変化する事業環境
- ・複雑なサプライチェーン
- ・顕在化する様々なリスク

①継続して効率化を推進

- ・13/3月期販管費予想は前期比+1.9億円、実行ベースで抑制

②人事プログラムや研修制度の充実、スキル保有者の採用(新卒/中途)

- ・幹部候補/海外駐在員/海外ローカル社員の育成を強化

③情報システムの拡充とロジスティクスの最適化

- ・利益/販売管理をサポートする情報システムの構築、W/Wで物流最適化を確立

④グローバル化の対応強化、与信/在庫/債権/為替等のリスク最小化

※①12年3月末人員 709名(前期比▲37名)

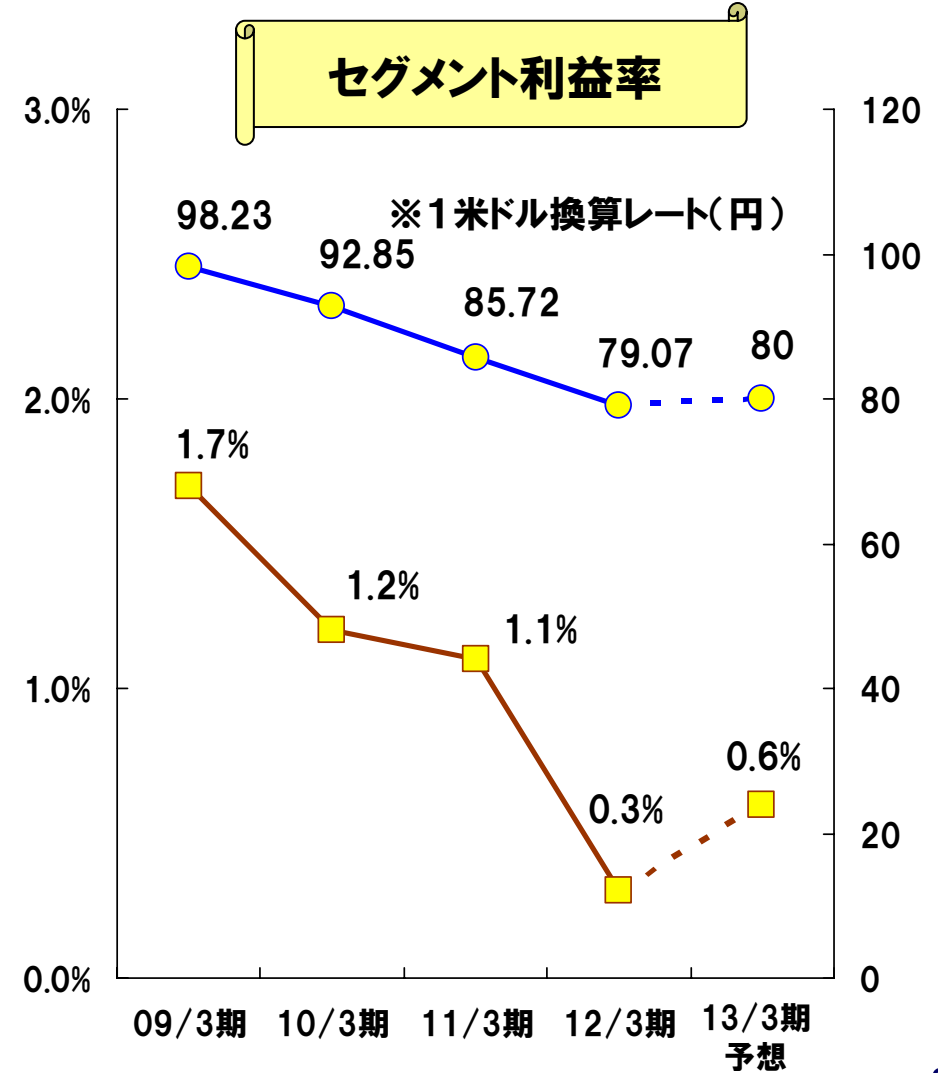
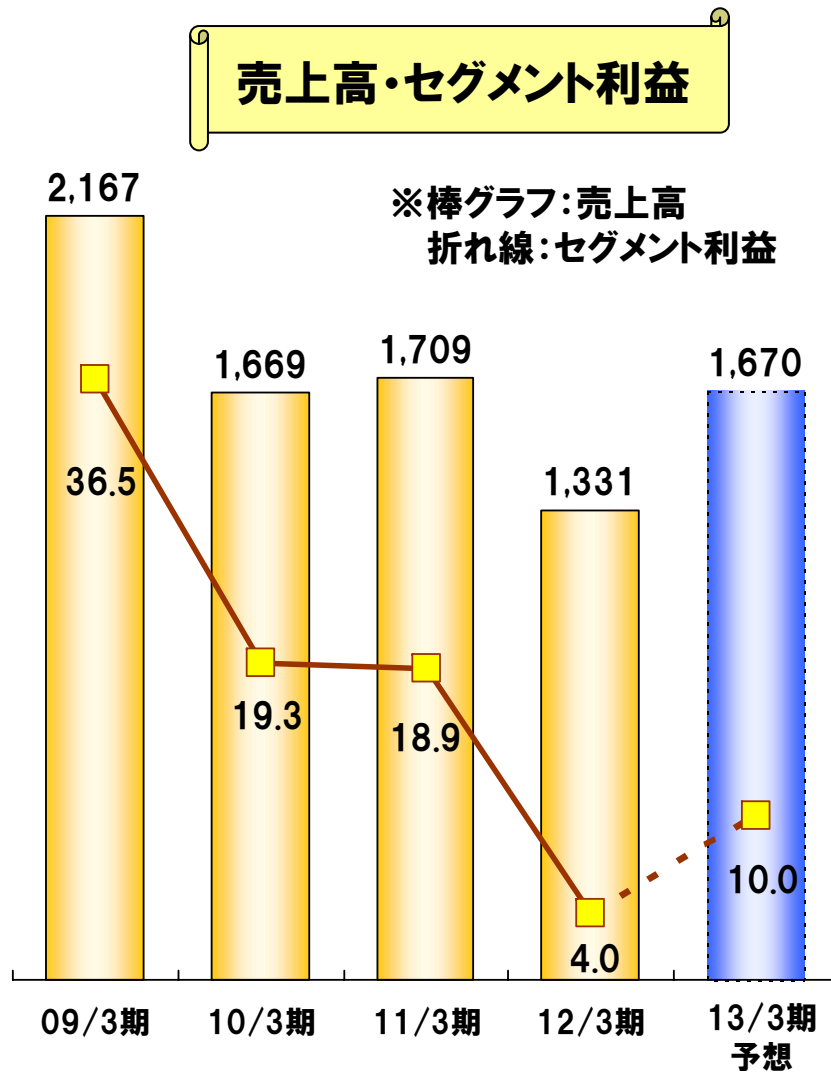
⇒内訳:デバイス事業451名(▲27名)、ソリューション事業179名(▲9名)、管理部門79名(▲1名)

※②期末人員は就業人員数(当社グループへの出向者を含み、当社グループ外への出向者を除く)

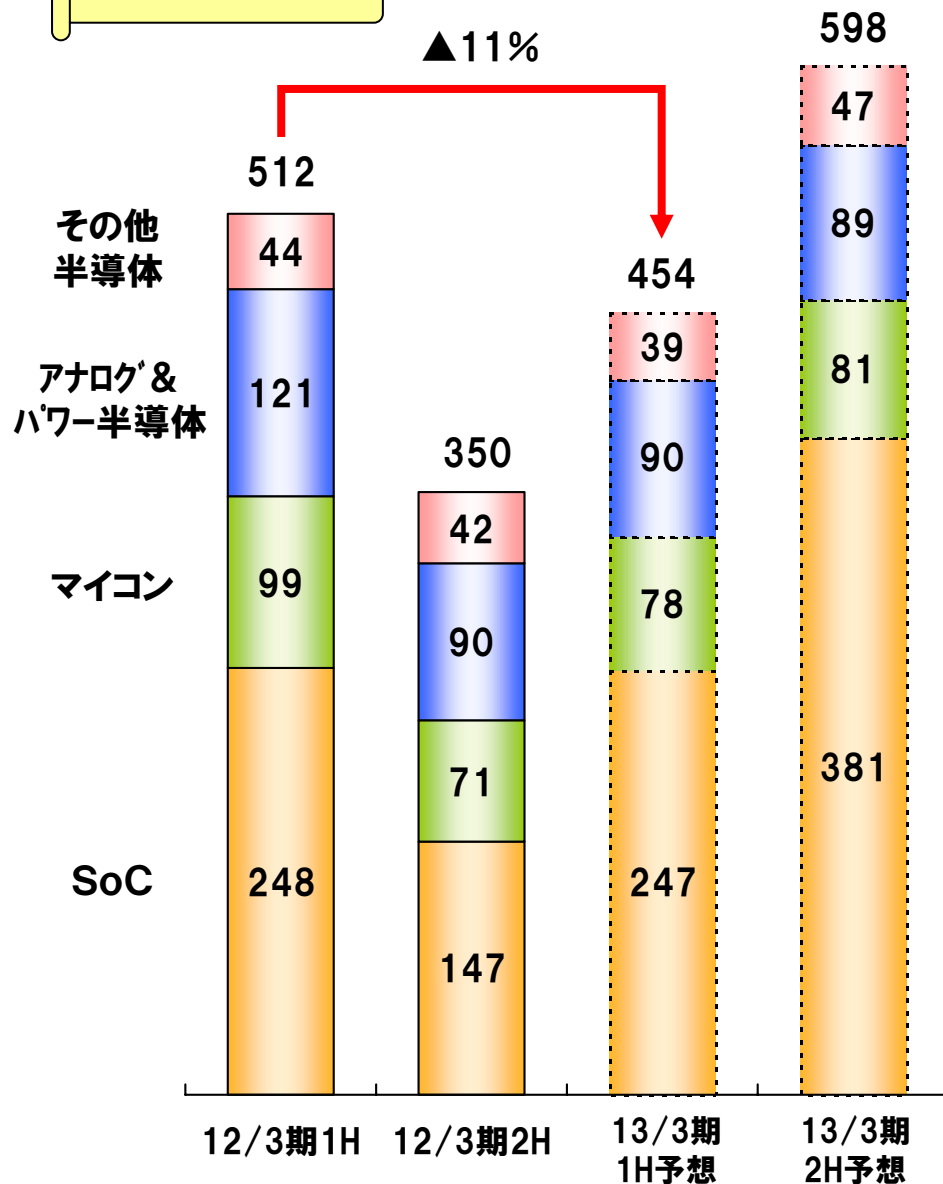
・ 2013年3月期 事業別業績予想

デバイス事業業績予想

■ 13年3月期予想は、売上高前期比+25%、セグメント利益前期比+151%
 →デジタル家電は低迷も新規セットの立ち上がりによる売上高の増加を見込む



半期売上高

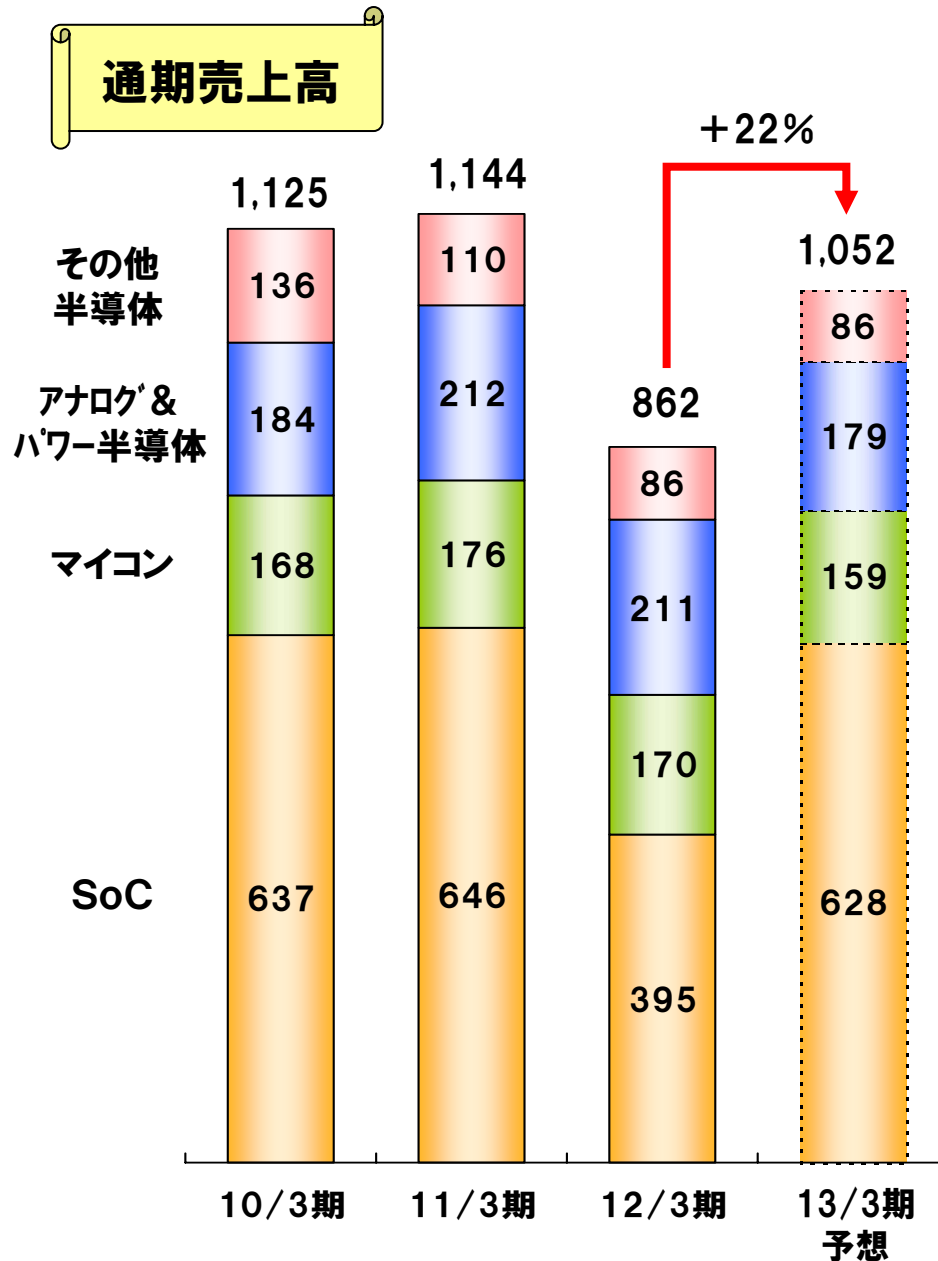


【前年同期比増減内容】

- SoC(システムLSI)
 - ゲーム機向けは増加
 - デジタル家電向けが減少
- マイコン
 - 車載向けは増加
 - デジタル家電/ゲーム機(含周辺)向けが減少
- アナログ&パワー半導体
 - 小型液晶パネル向けは増加
 - デジタル家電/大型液晶パネル向けが減少
- その他半導体
 - 携帯情報端末向けは増加
 - HDD向けが減少

	13年3月期1H予想	
	12/3期1H比	12/3期2H比
SoC	▲1%	+68%
マイコン	▲20%	+10%
アナログ&P半	▲26%	▲1%
その他半導体	▲12%	▲6%

通期売上高

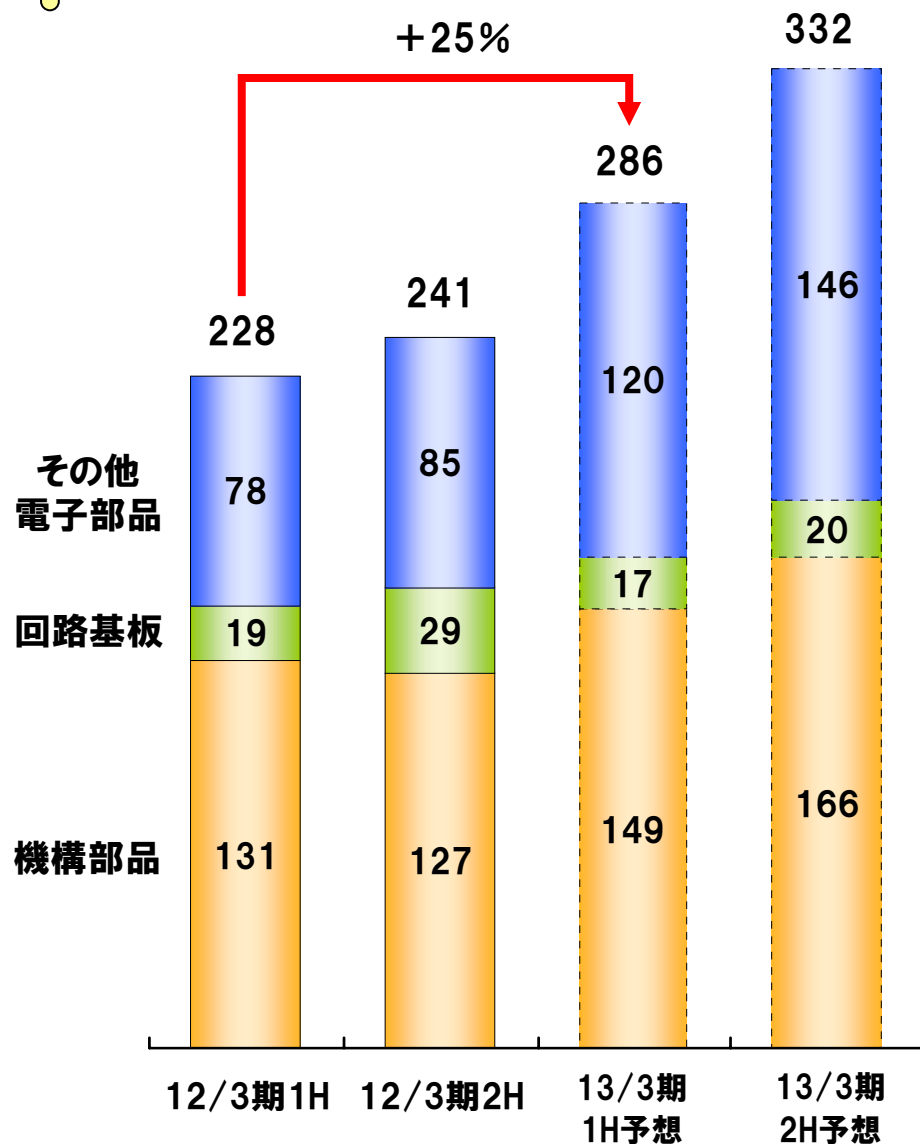


【前期比増減内容】

- SoC(システムLSI)
 - ゲーム機向けは増加
 - デジタル家電向けが減少
- マイコン
 - 車載/ゲーム機(含周辺)向けは増加
 - デジタル家電向けが減少
- アナログ&パワー半導体
 - 小型液晶パネル向けは増加
 - デジタル家電/大型液晶パネル向けが減少
- その他半導体
 - 携帯情報端末向けは増加
 - HDD向けが減少

	前期比
SoC	+59%
マイコン	▲7%
アナログ&P半	▲15%
その他半導体	+1%

半期売上高

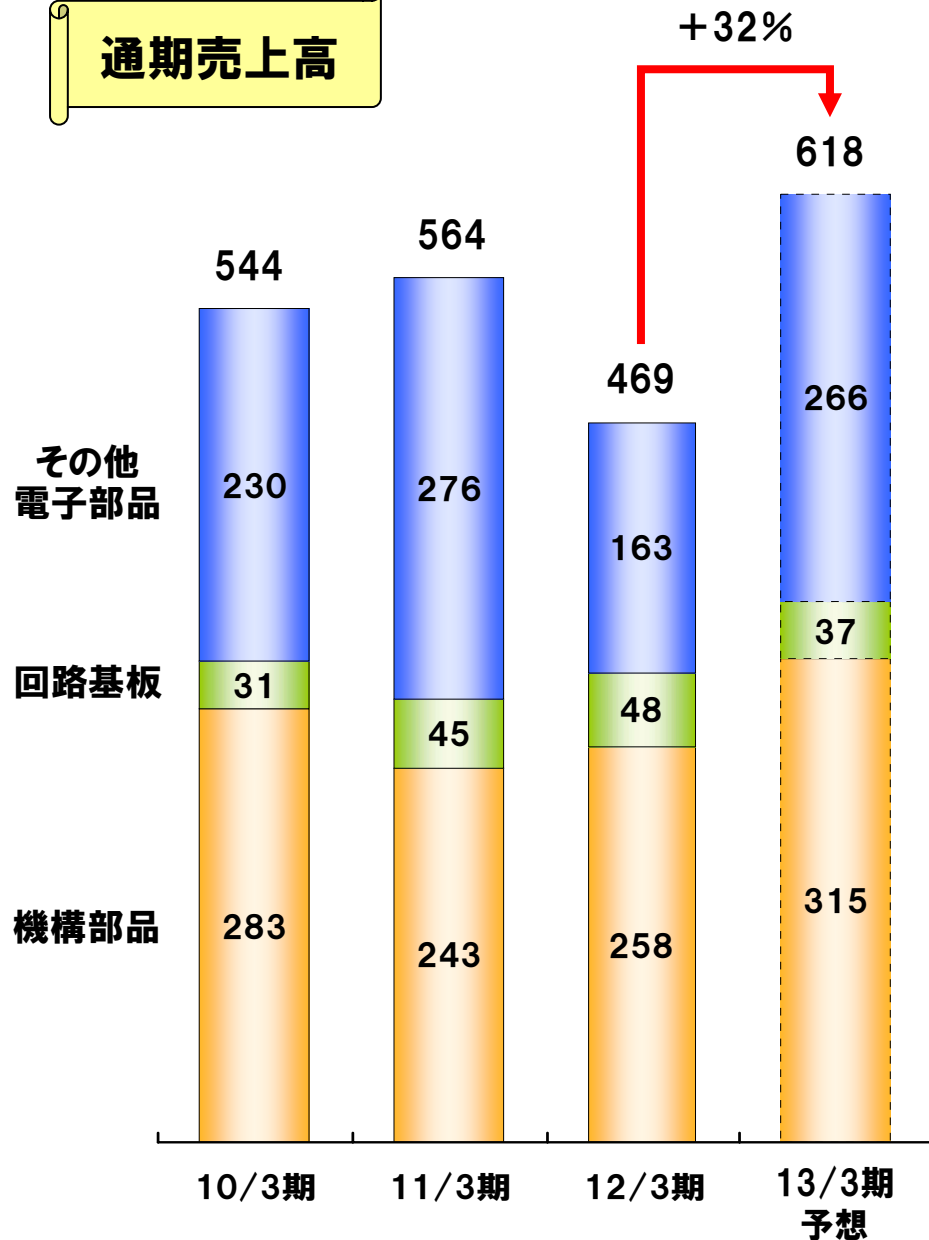


【前年同期比増減内容】

- 機構部品
 - 携帯情報端末向けは増加
 - デジタル家電/携帯電話向けが減少
- 回路基板
 - TV/携帯情報端末向けが減少
- その他電子部品
 - 素材、新規ビジネスは順調に増加

	13年3月期1H予想	
	12/3期1H比	12/3期2H比
機構部品	+13%	+18%
回路基板	▲11%	▲43%
その他	+54%	+40%

通期売上高

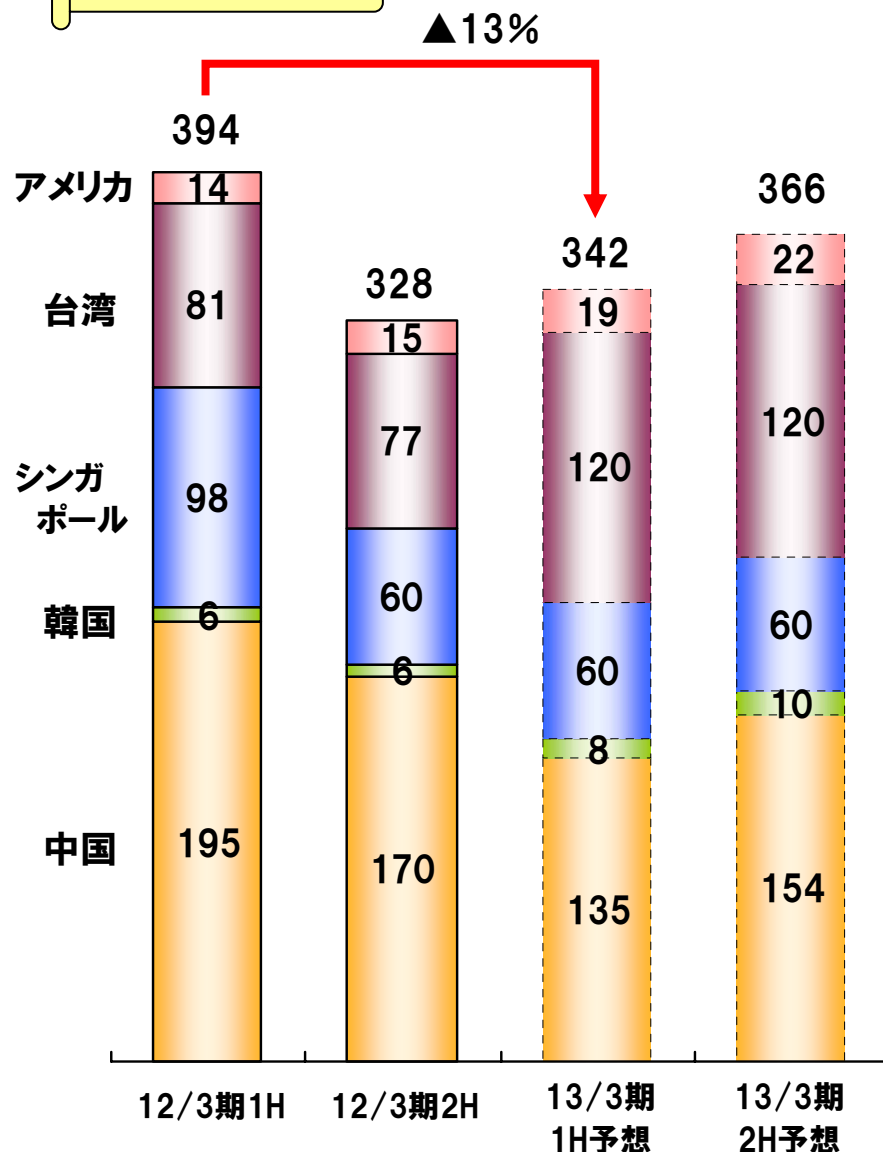


【前期比増減内容】

- 機構部品
 - 携帯情報端末/ゲーム機向けは増加
 - デジタル家電/携帯電話向けが減少
- 回路基板
 - TV/携帯情報端末向けが減少
- その他電子部品
 - 素材、新規ビジネスは順調に増加

	前期比
機構部品	+22%
回路基板	▲24%
その他	+63%

半期売上高



【前年同期比増減内容】

中国

- 携帯情報端末向け、新規ビジネスは増加
- デジタル家電/携帯電話/HDD向けが減少
- 非連結子会社への移管により減少

韓国

- 携帯情報端末等が増加

シンガポール

- デジタル家電/HDD向けが減少
- 非連結子会社への移管により減少

台湾

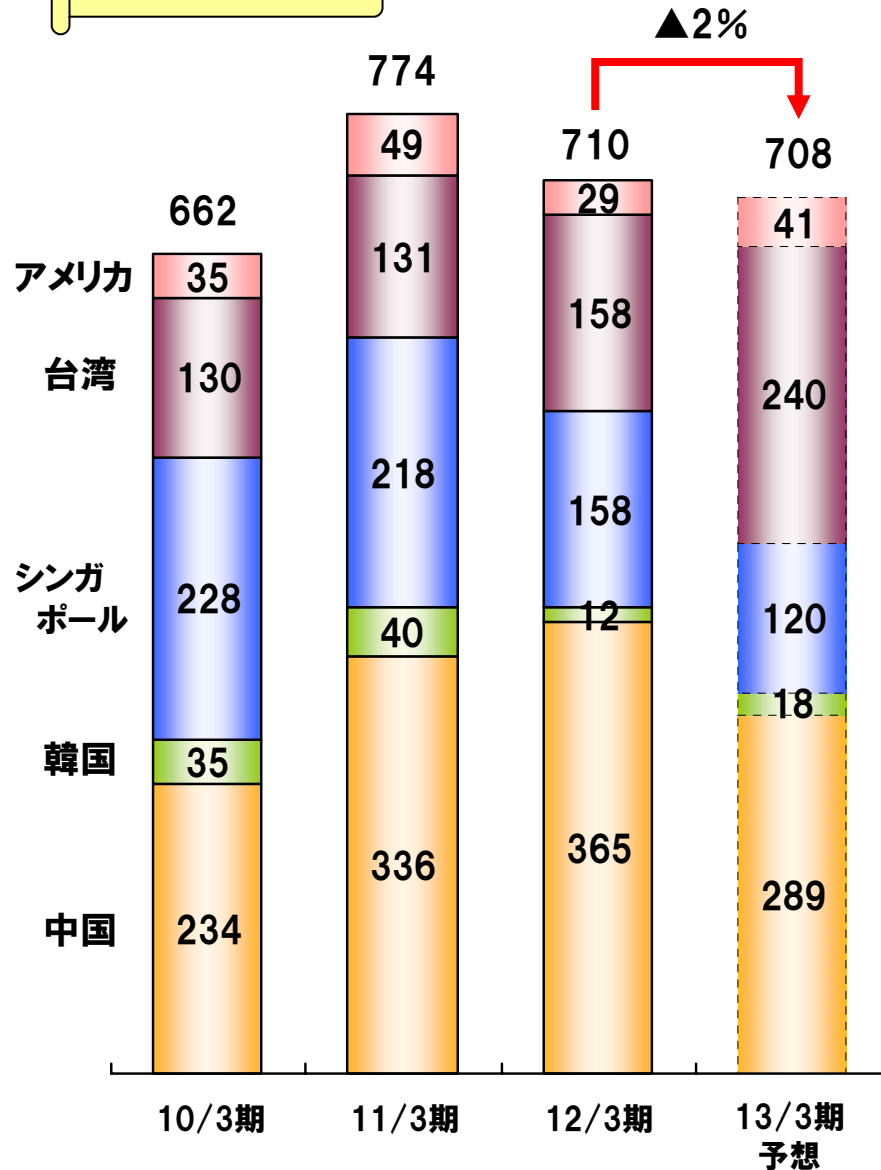
- 携帯情報端末/ゲーム機向け、新規ビジネスが増加

USA

- 無線関連IC等の新規ビジネスが増加

	13年3月期1H予想	
	12/3期1H比	12/3期2H比
中国	▲31%	▲20%
韓国	+32%	+40%
シンガポール	▲38%	+1%
台湾	+49%	+54%
アメリカ	+30%	+25%

通期売上高



【前期比増減内容】

中国

- 携帯情報端末向け、新規ビジネスは増加
- デジタル家電/携帯電話/HDD向けが減少
- 非連結子会社への移管により減少

韓国

- 携帯情報端末/車載向け等が増加

シンガポール

- デジタル家電/HDD向けが減少
- 非連結子会社への移管により減少

台湾

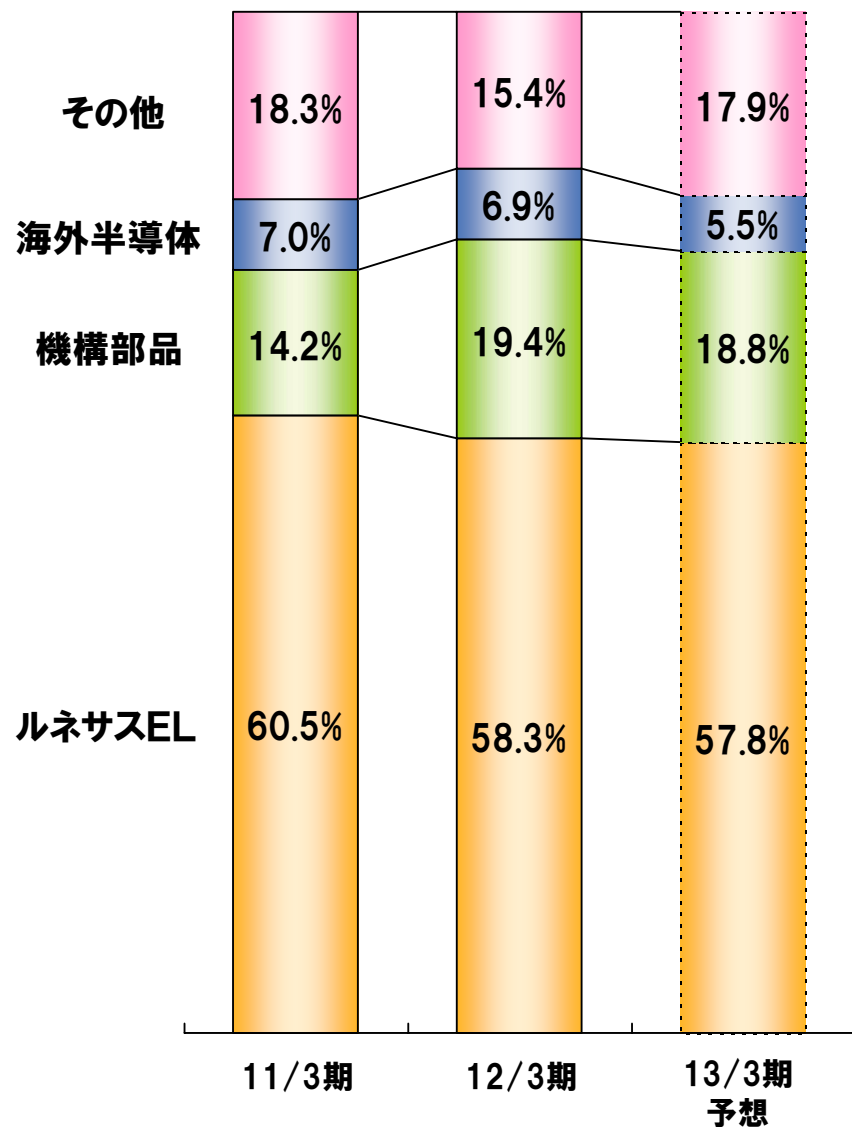
- 携帯情報端末/ゲーム機向け、新規ビジネスが増加

USA

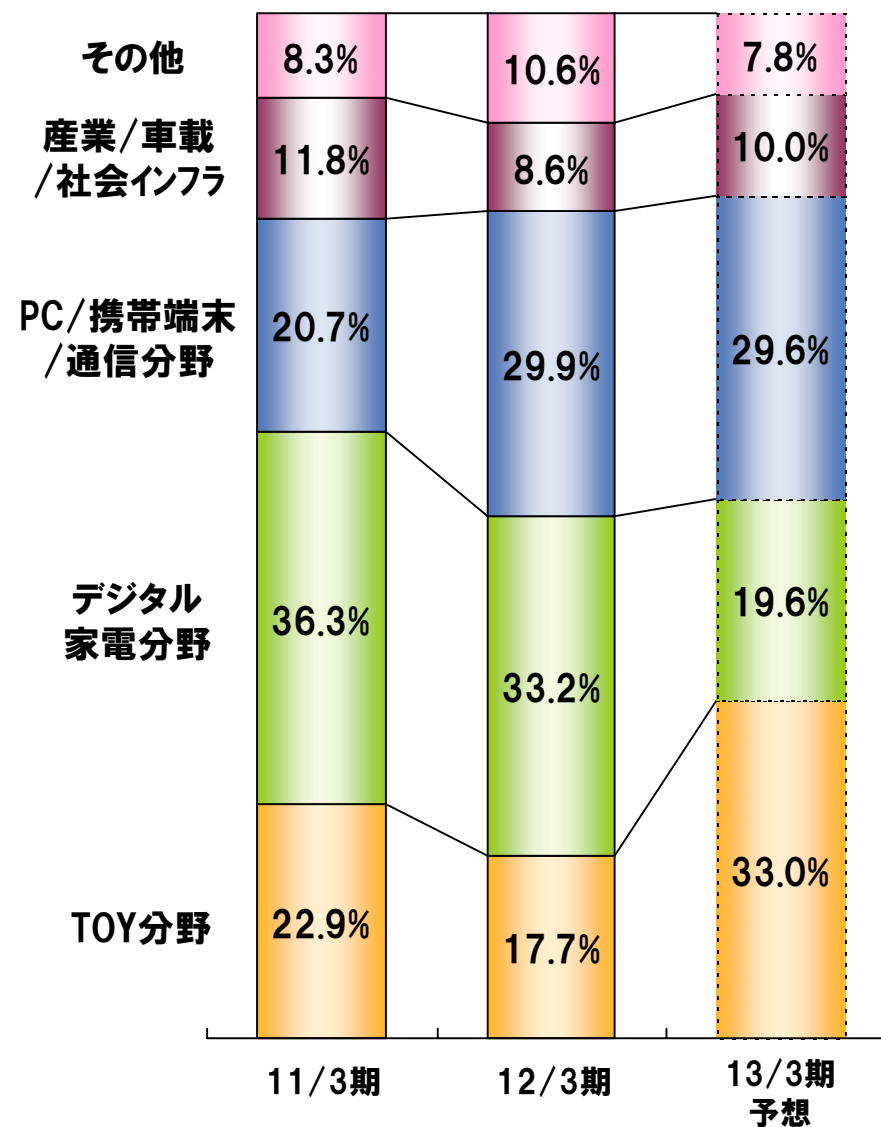
- 無線関連IC等の新規ビジネスが増加

	前期比
中国	▲21%
韓国	+50%
シンガポール	▲24%
台湾	+51%
アメリカ	+41%

製品別売上高構成比



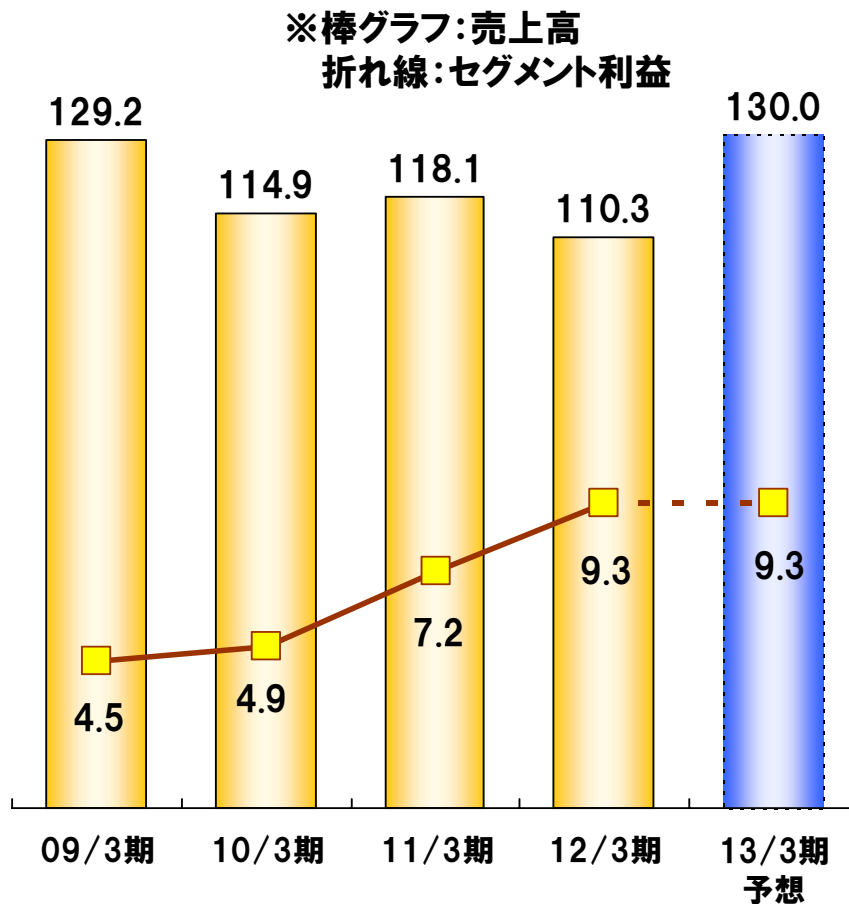
分野別売上高構成比



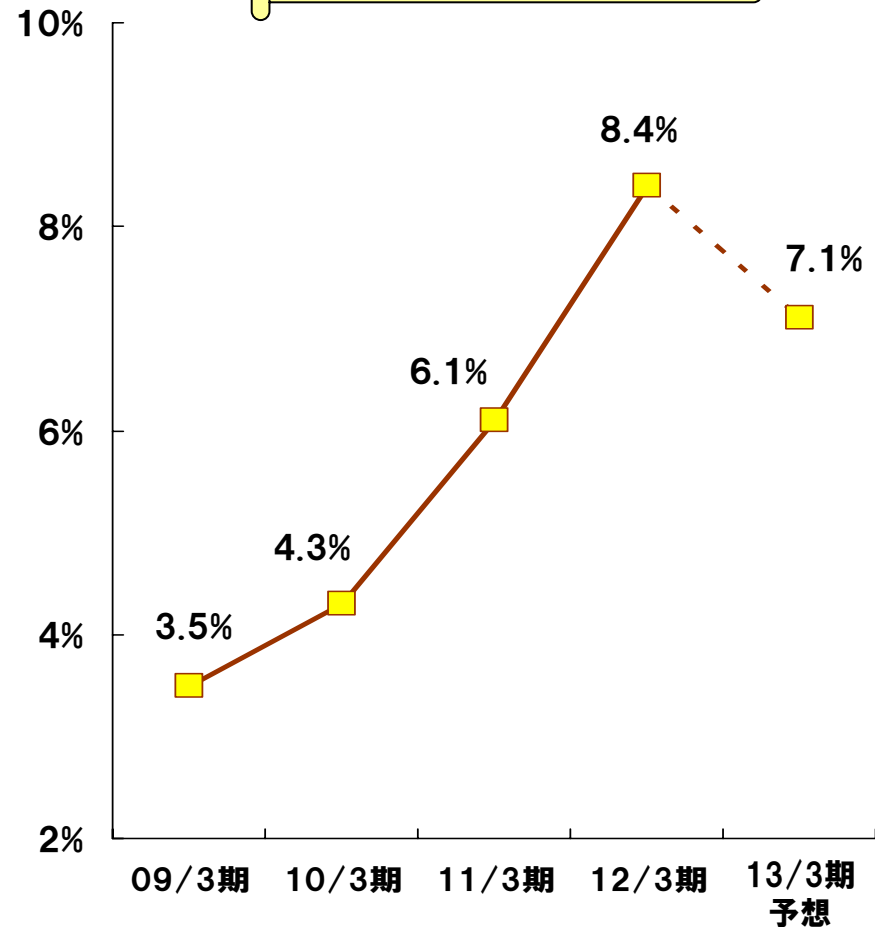
ソリューション事業業績予想

- 13年3月期予想は、売上高前期比+18%、セグメント利益前期比横這い
- セグメント利益は12/3期が過去最高益、今期も収益規模を全力で維持

売上高・セグメント利益



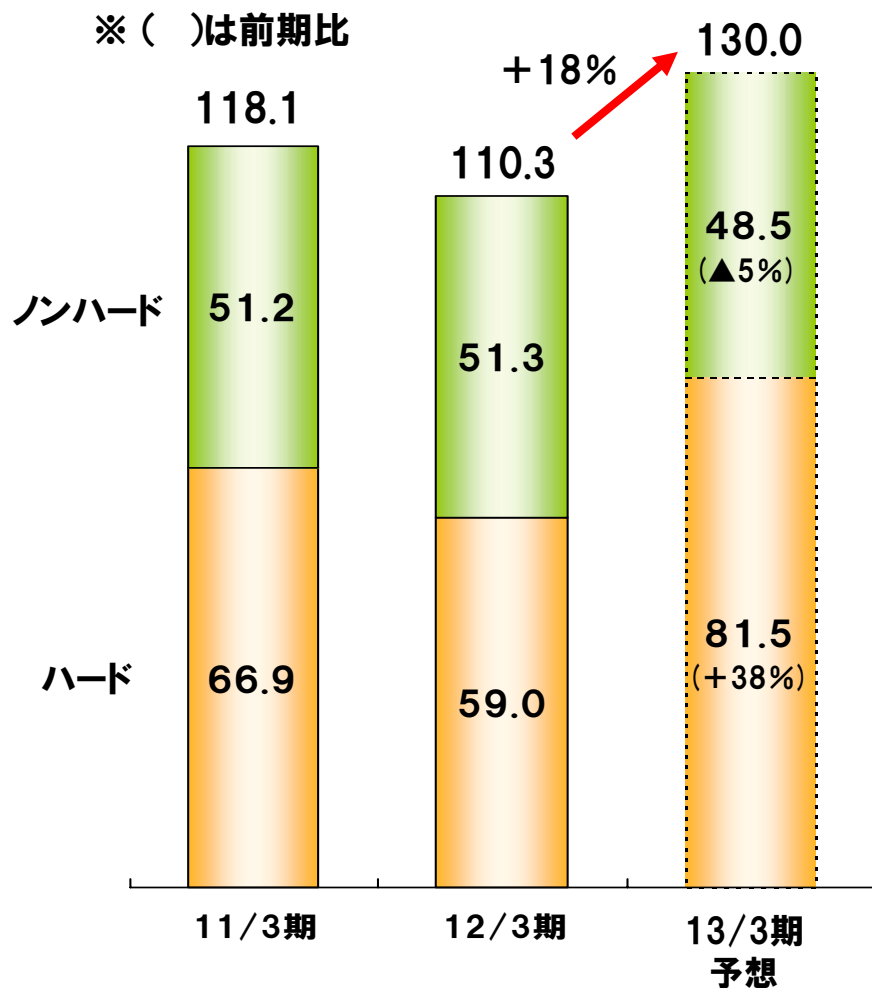
セグメント利益率



品目別売上高推移

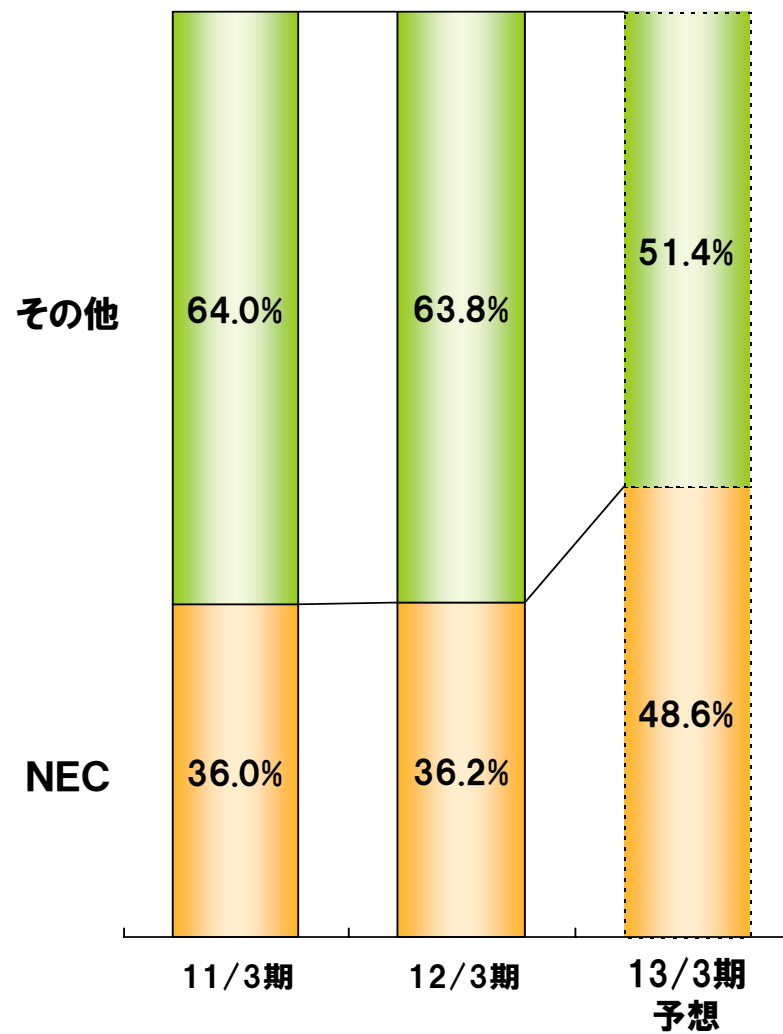
- ハード:公共向け/組み込み型OEM販売が増加
- ノンハード:ハード系/スポット保守が減少

※ ()は前期比

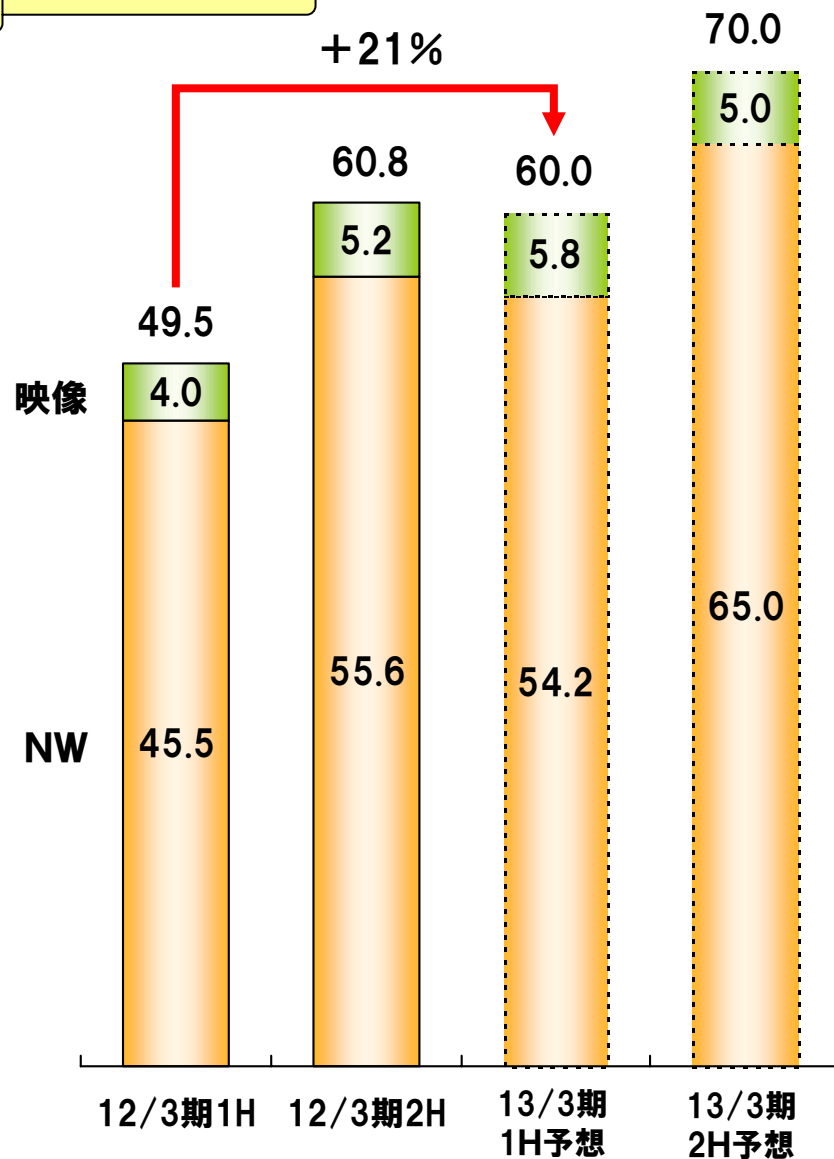


仕入先別売上高構成比

■ 13/3月期予想はNEC比率が48.6%に上昇



半期売上高



【前年同期比増減内容】

■ NWシステム関連

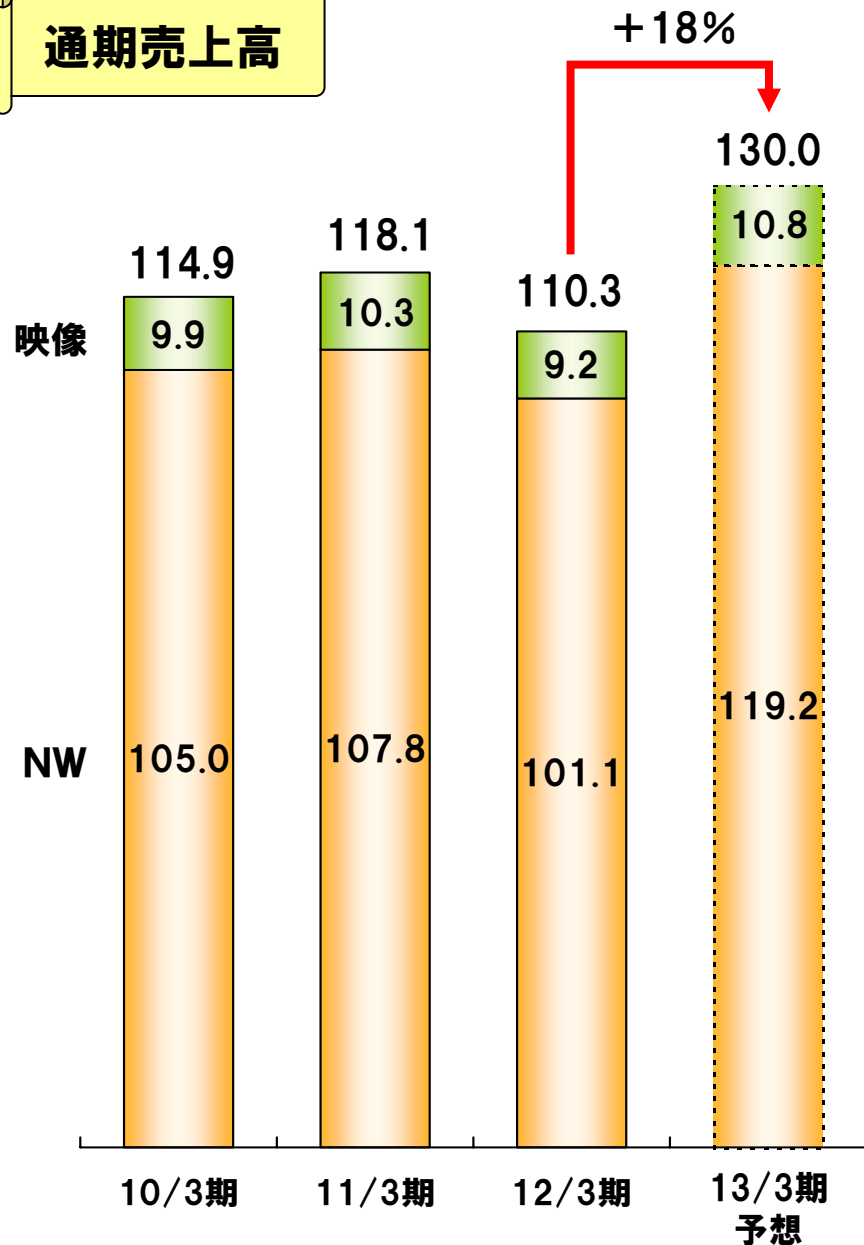
- 大手民間企業/アプリケーションソフトは微増
- 公共向けは、入札案件/消防防災が増加
- 組み込み型OEM販売が大幅増加

■ 映像システム関連

- 送出システムがHD化や更新により増加

	13年3月期1H予想	
	12/3期1H比	12/3期2H比
NWシステム関連	+19%	▲3%
映像システム関連	+46%	+12%

通期売上高



【前期比増減内容】

■ NWシステム関連

- 大手民間企業/アプリケーションソフトは微増
- 公共向けは、入札案件/消防防災が増加
- 組み込み型OEM販売は大幅増加

■ 映像システム関連

- 送出システムがHD化や更新により増加

	前期比
NWシステム関連	+18%
映像システム関連	+17%

・財務状況

科目	11年3月末 実績 A	12年3月末 実績 B	B-A 増減 (11/3対比)	13年3月末 予想 C	C-B 増減 (12/3対比)
現預金	68	152	84	100	△ 52
売掛債権	549	387	△ 162	525	138
棚卸資産	210	163	△ 47	165	2
その他資産	97	96	△ 1	80	△ 16
資産合計	924	799	△ 125	870	71
買掛債務	232	158	△ 74	225	67
有利子負債	78	35	△ 43	35	0
その他負債	18	19	1	18	△ 1
純資産合計	596	587	△ 9	592	5
負債・純資産合計	924	799	△ 125	870	71
自己資本比率	64.5%	73.5%	+9.0P	68.1%	△5.4P

科目	11年3月期 実績	12年3月期 実績	13年3月期 予想
売上債権の減少(△は増加)	△ 121.3	157.4	△ 138.2
棚卸資産の減少(△は増加)	△ 47.8	44.3	△ 1.7
仕入債務の増加(△は減少)	16.7	△ 71.8	67.2
その他	22.8	17.9	28.5
営業C/F	△ 129.6	147.7	△ 44.2
投資C/F	0.6	△ 8.3	△ 2.0
財務C/F	44.6	△ 55.5	△ 6.2
換算差額	△ 2.3	0.2	
現預金の増減額	△ 86.7	84.1	△ 52.4
現預金の期末残高	68.2	152.4	100.0

	09/3期 実績	10/3期 実績	11/3期 実績	12/3期 実績	13/3期 予想
①連結当期純利益	2,209百万円	1,340百万円	1,448百万円	516百万円	1,100百万円
②包括利益	—	1,223百万円	637百万円	492百万円	—
③連結自己資本比率	72.1%	68.6%	64.5%	73.5%	68.1%
④配当総額 (1株当り配当)	1,168百万円 (38円)	605百万円 (20円)	605百万円 (20円)	595百万円 (20円)	586百万円 (20円)
⑤連結配当性向	53.1%	45.2%	41.8%	117.0%	53.2%
⑥自己株式取得総額 (取得株式数)※	892百万円 (1,000千株)	—	—	766百万円 (1,000千株)	未定
⑦総還元性向 (④+⑥)÷①	93.3%	45.2%	41.8%	263.9%	未定
⑧自己株式消却	—	1,702千株	—	—	未定
⑨発行済株式総数 (除く自己株式)	31,983千株 (30,281千株)	30,281千株 (30,281千株)	30,281千株 (29,280千株)	30,281千株 (29,280千株)	30,281千株 (未定)
⑩1株当たり当期純利益	71.61円	44.28円	47.81円	17.10円	37.57円
⑪1株当たり純資産	1,956.15円	1,967.08円	1,968.14円	2,005.34円	2,022.88円

※ 自己株式取得には単元未満株式の買取請求に伴う取得分は含まれておりません。

●基本方針

- 利益還元の拡大と内部留保の充実

●13年3月期 配当予想

- 連結業績は増収増益の見通し、安定的な配当の実施を重視
- 前期と同額の1株当たり20円（中間、期末各10円）
- 連結配当性向 53.2%
- 09年3月期～13年3月期平均連結配当性向 53.8%